

接点部品への低リン SUPER SEK-797

特性の概要

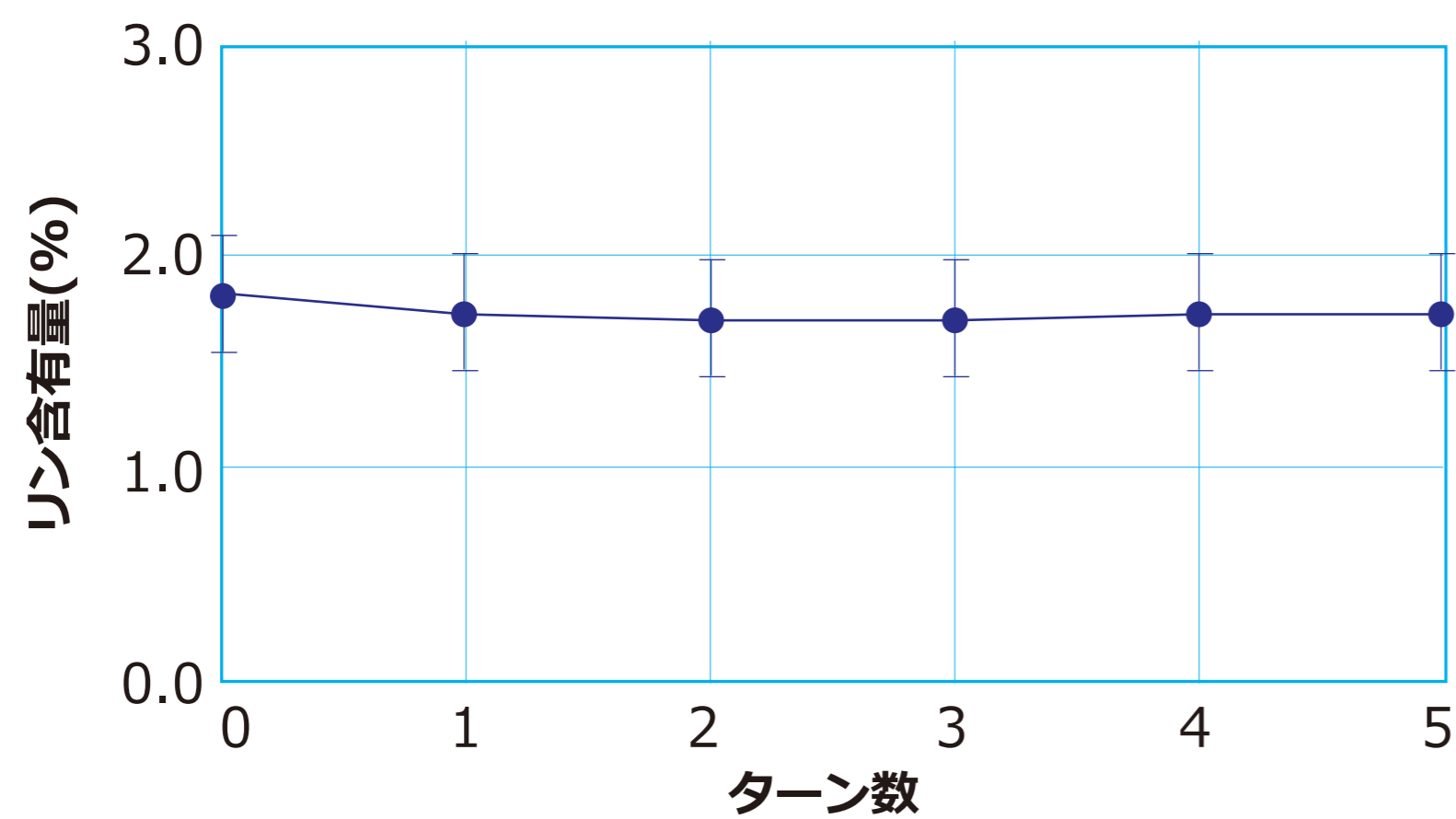
皮膜中のリン含有率 (wt%)	1~2
めっき速度 ($\mu\text{m/hr}$)	14~20
析出時の皮膜硬度 (Hv)	650~700
電気抵抗率 ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	50

アルミ・銅・樹脂等
高硬度皮膜として最適！

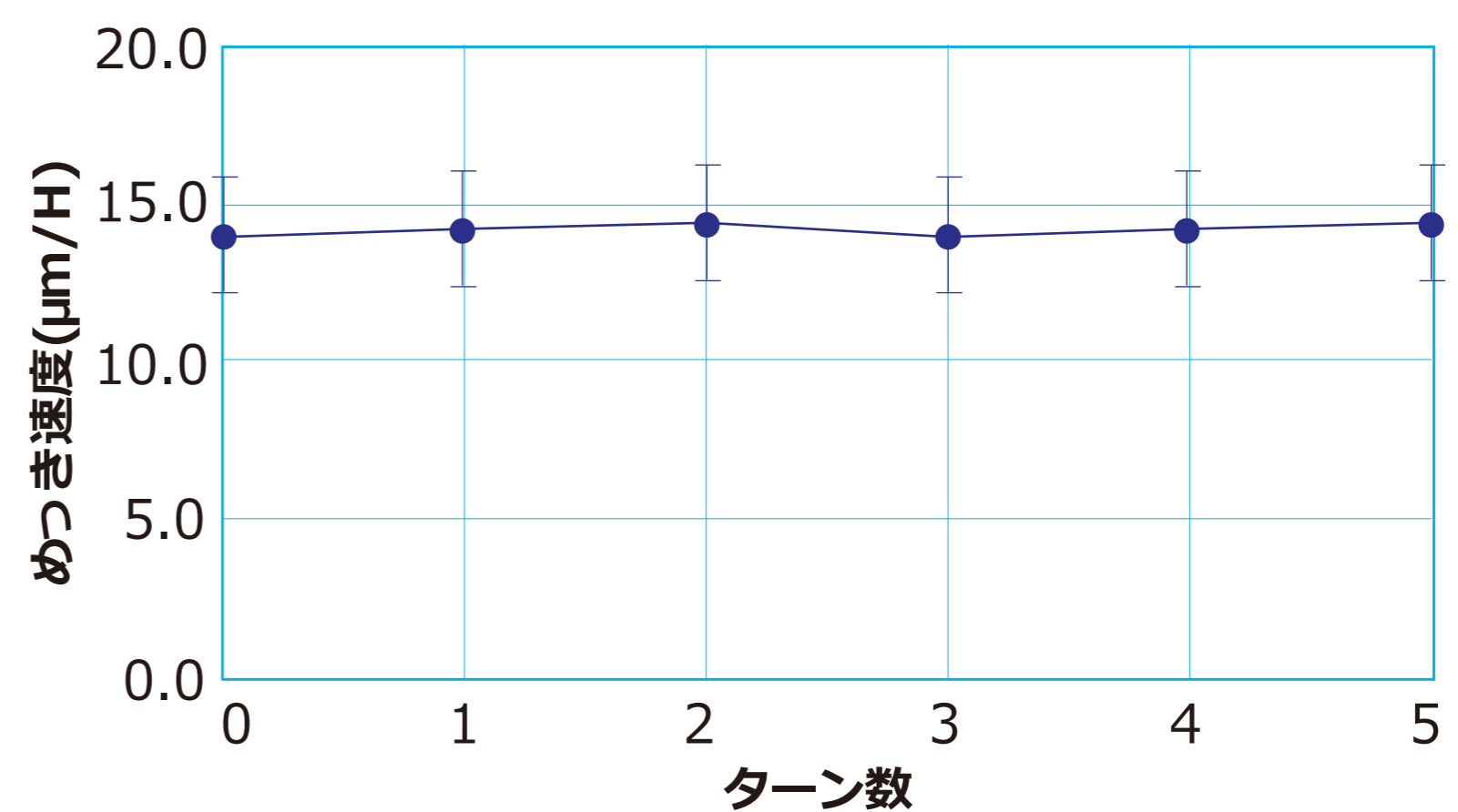
過酷な条件下での
接点材料として最適！

めっき作業に配慮した設計

リン含有量の安定性



めっき速度の安定性



低リンPbフリーSEK-797の特徴

- Cu 配線上に欠陥が無い緻密な皮膜を被覆させることが可能
- 液の構成を、新しい方式を採用した CP 方式にて運用することが可能
【※CP 方式：PH 調整剤（苛性ソーダ）をユーザーサイドで調達を可能にし、コスト対策に寄与する方式】
- リン含有量が少ないため、電気特性及び皮膜硬度に優れている
- リン含有量が MTO 後半においても、安定して 1~2% を維持することができる
- 均一で寸法精度に優れている